

출력 일자: 2003/6/2

발송번호 : 9-5-2003-020719761  
발송일자 : 2003.05.31  
제출기일 : 2003.07.31

수신 : 서울 강남구 역삼1동 648-23 여삼빌딩 901  
호  
윤동열 귀하

특허청  
의견제출통지서



출원인 명칭 가부시키가이샤 무라타 세이사쿠쇼 (출원인코드: 519980960646)  
주소 일본국 교토후 나가오카쿄시 덴진 2초메 26방 10고  
대리인 성명 윤동열 외 1명  
주소 서울 강남구 역삼1동 648-23 여삼빌딩 901호  
출원번호 10-2001-0082648  
발명의 명칭 탄성 표면파 장치 및 그 제조 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지합니다. 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 전항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

- 아래 -

1. 본원발명의 청구범위 전항은 탄성표면파장치 및 그 제조방법에 관한 것으로서 압전기판을 준비하는 단계, 전극층을 형성하는 단계, 배선전극을 형성하는 단계 및 압전기판, 소자용전극, 전극패드, 배선전극등으로 구성된 것을 특징으로 하는데, 이는 탄성표면파디바이스의 제조방법에 관한 것으로서 압전재료, 전극, 본딩패드, 배선전극등으로 구성된 것을 특징으로 하는 인용발명 1(일본국 특개평 1-103010호)과 탄성표면파 장치의 제조방법에 관한 것으로서 압전기판 표면에 전극패턴을 형성하는 공정, 접착제로 고착하는 공정, 금속와이어를 형성하는 공정등으로 구성된 것을 특징으로 하는 인용발명 2(일본국 특개소 63-127610호)의 결합으로부터 당업자라면 본원을 용이하게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

[첨부]

첨부 1 인용발명 1: 일본공개특허공보 평01-103010호(1989.04.20) 1부  
첨부2 인용발명 2: 일본공개특허공보 소63-127610호(1988.05.31) 1부 끝.

2003.05.31

특허청

심사4국

전자심사담당관실

심사관 김재문



출력 일자: 2003/6/2

<<안내>>

귀하께서는 특허법 제47조 제2항의 규정에 의거 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 명세서 등을 보정할 수 있음을 알려드립니다. 문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5673 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))내 부조리신고센터